



第二工場の生産設備

- 本社所在地：京都府久世郡久御山町野村村東187-2
- 事業概要：半導体製造装置、FPD製造装置、検査・測定装置、産業用ロボットおよび一般精密機器の精密部品加工
- 常時使用する従業員：72名
(2025年11月時点)
- 現在の売上高：23.5億円
(2025年10月期)
- 法人番号：1130001014976
- Web：<https://www.takahala.co.jp/>

企業理念・100億宣言に向けた経営者メッセージ



代表取締役
高原 大

真空技術とマルチマテリアルの融合で、世界のイノベーションを支え 精密の先にある未来を創る。

当社は京都・久御山の地で、半導体製造装置の心臓部を支える精密加工技術を磨いてきました。100億企業への挑戦は、単なる規模の拡大ではありません。最新の「電子ビーム溶接」による真空装置への進出、そして樹脂や脆性材加工企業とのM&Aを通じ、あらゆる素材（マルチマテリアル）を高精度につなぎ合わせる「唯一無二の技術集団」へと進化するための決意です。既存事業の深掘りと新領域への果敢な挑戦、そして志を同じくする仲間との統合により、お客様の想像を超える価値を提供し、地域社会と日本のモノづくりの発展に貢献し続けます。

売上高100億円実現の目標と課題

実現目標

電子ビーム溶接を武器とした「真空装置案件」の新規獲得と戦略的M&Aによる多素材対応力の強化により、2035年に売上高100億円を達成する。
売上高100億円の達成予定年：2035年

課題

先端技術（EB溶接）の習熟と市場浸透：高度な加工ノウハウの蓄積と装置メーカーに対する設計段階からの技術提案力の強化が不可欠。
M&Aを通じた多素材対応力のシナジー創出：金属・樹脂・脆性材という異なる加工文化を統合し、「マルチマテリアル・ワンストップ」の価値を早期に提供できるPMI体制の構築。
組織規模拡大に伴うマネジメント層の育成：売上の急拡大を支えるため、現場の技能継承だけでなく、グループ全体を俯瞰できる次世代経営管理層の育成とDXによる生産管理の高度化が急務。

売上高100億円実現に向けた具体的措置

目指す成長手段

設備投資（スマートファクトリー化）：最新工作機械の導入による生産能力増強に向け、多軸マシニングセンタとロボットによる自動化セルを増設し、24時間稼働体制を確立。
真空装置ビジネスへの参入：電子ビーム溶接技術を活用し、引合が増加している高付加価値な真空容器・装置案件を新規受注し生産を拡大。
戦略的M&Aの実行：2031年に樹脂加工、2035年に脆性材加工の有力企業を統合し、対応領域を劇的に拡大させ既存事業とのシナジーで売上を拡大。

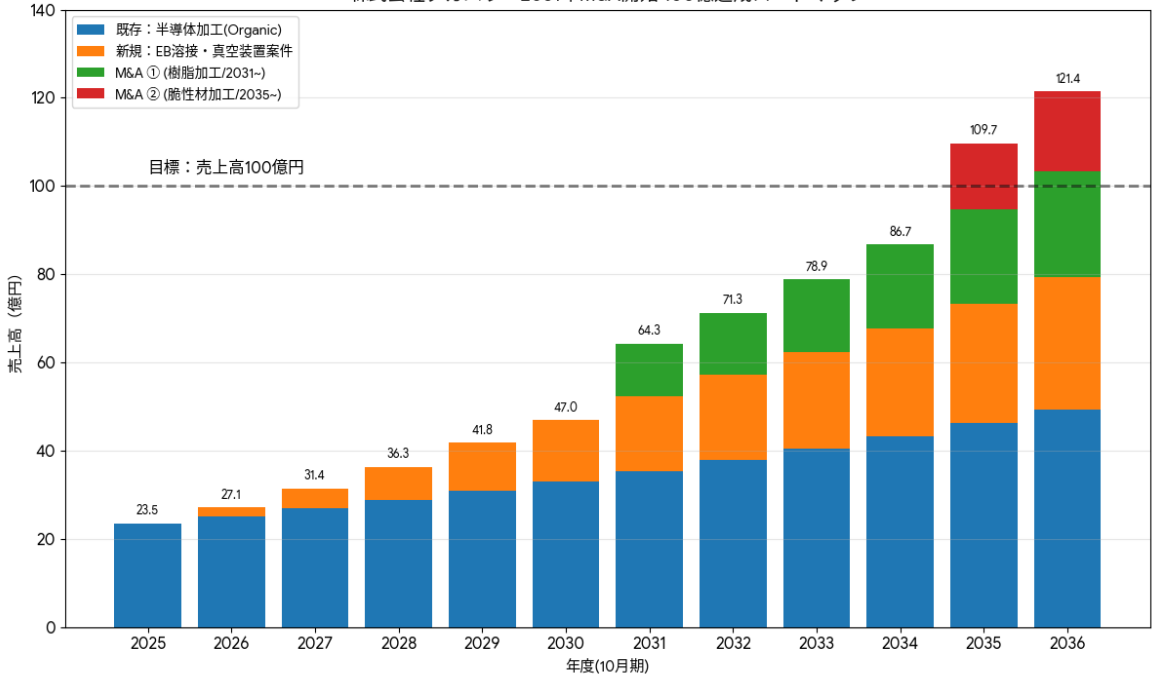
実施体制

「真空装置プロジェクトチーム」を発足させ、EB溶接を活用した新工法提案営業を強化。
「PMI（買収後統合）推進室」を設置し、M&A先の技術と自社拠点のシナジーを最大化する生産管理体制を構築。

※本宣言は企業自身はその責任において売上高100億円を目指して、自社の取組を進める旨を宣言するものです

売上高シミュレーション

株式会社タカハラ：2031年M&A開始 100億達成ロードマップ



単位：億円（各年10月期決算想定）

年度	既存：半導体加工	新規：EB溶接・真空	新規：M&A ① (樹脂)	新規：M&A ② (脆性材)	合計売上	備考
2025	23.5	-	-	-	23.5	実績（起点）
2026	25.1	2.0	-	-	27.1	EB溶接(EBW)機導入
2027	26.9	4.5	-	-	31.4	真空装置の一貫受注開始
2028	28.8	7.5	-	-	36.3	真空チャンバ-案件拡大
2029	30.8	11.0	-	-	41.8	EBW技術の熟成期
2030	33.0	14.0	-	-	47.0	M&Aに向けた体制構築
2031	35.3	17.0	12.0	-	64.3	M&A①実施（樹脂加工）
2032	37.8	19.5	14.0	-	71.3	金属×樹脂の複合提案開始
2033	40.4	22.0	16.5	-	78.9	顧客内シェアの拡大
2034	43.2	24.5	19.0	-	86.7	グループ間シナジー発揮
2035	46.2	27.0	21.5	15.0	109.7	M&A②実施（脆性材加工）
2036	49.4	30.0	24.0	18.0	121.4	売上100億達成・定着